

TSIA 半導體獎：博士研究生申請辦法

民國一一〇年九月二十九日修訂

一、目的：

台灣半導體產業協會(以下稱本會)為獎勵國內傑出博士研究生積極從事半導體之學術研究、發明或致力投入產業合作並有具體貢獻者，特訂定本辦法。

二、獎項：

「TSIA 半導體獎：博士研究生」十名，每名頒給獎牌乙座、並將其個人貢獻事蹟公告予本會之會員廠商並發表讓社會知悉及獎金新台幣 8 萬元整。

三、申請資格：

3-1 自 2022 年起從國立台灣大學、國立清華大學、國立陽明交通大學、國立成功大學、國立中央大學、國立中正大學、國立中興大學、國立中山大學，北科大、台科大與高科大共十一所大學之博士研究生中進行推薦，未來將陸續推廣至其它公私立大學。

3-2 已通過博士資格考之博士班研究生。

3-3 經指導教授推薦者。

四、申請時間：

本會於每年 10 月上旬函告各校並開放受理申請。受理申請時間為每年 10 月 15 日至 12 月 15 日止。

五、遴選委員會

由台灣半導體產業協會理事長為遴選委員會主委或委任，並邀請在半導體領域已有卓越成就之學者、專家及產業領導者為委員。

六、頒獎日期：

於次年之本會會員大會或年會中頒獎，獲獎者須親自出席受獎。因故經 TSIA 遴選委員會同意，理監事會核備，同意由其指導教授或該單位最高研發主管出席，受獎得改由他人代之。

七、申請方式：

7-1 申請者備妥申請文件，向各校校方提出申請；本會不直接受理申請。

7-2 請各校於申請截止日期前，向本會推薦。

附件一、「TSIA 半導體獎：博士研究生」申請表

申請編號 (由本會填寫)		申請日期 (西元年/月/日)	
-----------------	--	-------------------	--

一、個人基本資料：

學校名稱(全稱)	(中文)		
	(英文)		
系所名稱(全稱)	(中文)		
	(英文)		
申請人	(中文姓名)		(英文姓名)
身份證字號		生日	西元 年 月 日
戶籍地址			
通訊地址	(含 6 碼郵遞區號)		
電話	(市話) (手機)	Email	

二、學歷狀況：(請依最高學歷往下填寫)

學位	學校	科系	修習期間 (西元年/月~西元年/月)

三、工作經歷：(若有請填寫，並依最近工作經歷往下填寫)

任職公司	部門/職位	工作內容	任職期間 (西元年/月~西元年/月)

四、研究績效(含論文著作、專利發明、軟體、產品、產學合作、獲獎紀錄等)，依重要性排序，最多 8 項，每項扼要敘述最多 5 行。

- 1.
- 2.
- 3.

八、學生證正反面影本

<p>學生證正面黏貼處</p>	<p>學生證反面黏貼處</p>
-----------------	-----------------

身份證正反面影本

<p>身份證正面黏貼處</p>	<p>身份證反面黏貼處</p>
-----------------	-----------------

九、應備文件點檢表：

項目	請打“v”	文件名稱
9-1		申請表正本(有制式表格，請向各校索取-附件一)。
9-2		推薦函正本(有制式表格，請向各校索取-附件二)。
9-3		學生證及身份證正反面影本各乙份(請貼於本申請表)。
9-4		博士班修習期間成績單正本。
9-5		參與半導體學術研究、著作論文、發明成果、獲獎紀錄、專利榮譽、特殊貢獻、產學合作等傑出事蹟之相關佐證資料。
9-6		請連結網址 https://forms.gle/arYxSzQ9H9L6esDX8 ，填寫基本資料，並將 9-1~9-5 文件掃描為單一 PDF 檔案後上傳，以利建檔。